

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成16年8月19日(2004.8.19)

【公開番号】特開2002-280748(P2002-280748A)
【公開日】平成14年9月27日(2002.9.27)
【出願番号】特願2001-81815(P2001-81815)
【国際特許分類第7版】
H05K 3/46
【FI】
H05K 3/46 Z

【手続補正書】
【提出日】平成15年8月4日(2003.8.4)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

複数の基板を多層構造にした多層基板に直流回路と高周波回路とを形成してなる高周波基板構造であって、
前記直流回路形成部分は前記多層基板の一方の面に設けられた外層及び前記多層基板内に
設けられた内層に配線パターンを形成する構造とし、前記高周波回路形成部分は前記外層
のみに配線パターンを形成する構造としたことを特徴とする高周波基板構造。

【請求項2】
前記直流回路形成部分の外層と前記高周波回路形成部分の外層を同一層としたことを特徴とする請求項1記載の高周波基板構造。

【請求項3】
前記基板の一方の外層側をグランド層とし、他方の外層側を前記直流回路形成部分及び前記高周波回路形成部分の各外層として用いることを特徴とする請求項1記載の高周波基板構造。

【請求項4】
前記高周波回路は、前記基板の外層に形成されたストリップラインを備えることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高周波基板構造。

【請求項5】
前記高周波回路における前記基板の両方の外層を、スルーホールで接続したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高周波基板構造。

【請求項6】
前記直流回路における前記基板の各層の間をスルーホールで接続したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高周波基板構造。

【請求項7】
前記高周波回路の両側に前記直流回路を設けたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高周波基板構造。

【請求項8】
前記直流回路の両側に前記高周波回路を設けたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高周波基板構造。

【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 8

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明に係わる高周波基板構造は、複数の基板を多層構造にした多層基板に直流回路と高周波回路とを形成してなる高周波基板構造であって、前記直流回路形成部分は前記多層基板の一方の面に設けられた外層及び前記多層基板内に設けられた内層に配線パターンを形成する構造とし、前記高周波回路形成部分は前記外層のみに配線パターンを形成する構造としたことを特徴とする。

また本発明に係わる高周波基板構造では、前記高周波回路に、前記基板の外層に形成されたストリップラインを備えることを特徴とする。